This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(11) Publication number:

57

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 55096888

(51) Intl. Cl.: C25D 5/10

(22) Application date: 17.07.80

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

06.02.82

(84) Designated contracting

states:

(72) Inventor: HIGUCHI YUKINOBU

(71) Applicant: NIPPON STEEL CORP

TSUKAMOTO YUKIO KAMATA MINORU OGA TOMOYA

(74) Representative:

(54) STEEL PLATE FOR WELDED CAN AND CONTAINER AND PREPARATION THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare the tittled steel plate having a low amount of Sn plating, exellent weldability and excellent corrosion resistance after painting, by plating the surface of a steel plate with Ni before plating with Sn and subsequently by treating the surface by heating and melting before treating with chromate.

CONSTITUTION: The surface of the steel plate is plated with 30W1,000mg/m2 of Ni per one side. Subsequently, the plated surface is further plated with 100W 2,000mg/m2 of Sn per one side. Next, the plated surface is treated by heating and melting (melt-treated) at 240W350°C, and then followed by the formation of a coating layer comprising 2W20mg/m2 converted into Cr of

chromate.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

(19 日本国特許庁 (JP)

⑩公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭57—23091

60Int. Cl.3 C 25 D 5/10 識別記号

广内整理番号 6575-4K

昭和57年(1982)2月6日

発明の数 密查請求 未請求

(全 5 頁)

匈溶接缶容器用鋼板とその製造法

御特

昭255-96888

の出

昭55(1980)7月17日

70発

樋口征順

北九州市戸畑区沢見1丁目7-

者 塚本幸雄 明 伽発

北九州市八幡西区泉ケ浦1丁目

明 者 蒲田稔 伽発

北九州市戸畑区椎ノ木町16-54

大賀智也 明

北九州市戸畑区鞘ケ谷町21-2

新日本製鐵株式会社 MB

東京都千代田区大手町2丁目6

番3号

弁理士 吉島寧

密接容器用鋼板及びその製造法

- 特許請求の範囲
- 剱板表面に片面当り30~1000g/㎡の Ni メッキ層と 5 0 ~ 2 0 0 0 町 / ㎡の En メッキ 磨とさらに Cr換算量で 2 ~ 2 0 m/ π²のクロ メー ト被膜層で形成されていることを特徴とする密接 容器用鋼板。
- (2) 剱板表面に片面当り30~1000*叫/* n¹の Ni メッキと、100~2000四/㎡のSnメッキを施 して温度240~350℃で加熱溶融処理を施し た後、Cr換算量で2~20g/ゕロクロメート被 膜層が形成することを特徴とする溶接容器用網板 の製造法。
- 発明の詳細な説明

本発明は製缶用業材として、特に溶接性、塗装 後の耐食性に優れた溶接容器用鋼板及びその製造 方法に関するものである。

近年、 電気抵抗 密接 方式の 進歩と 相俟つて、

接方式(例えばスートロニック格接)による製缶 方式の進歩が著しい。これらの要求に対処するた め暦接性に優れるとともに、製缶用累材(容器用 劔板)として要求される性能、耐食性、塗装性能 Costの安い容器用鋼板が要求される。

従来から、容器用鋼板として Snメツキ鋼板(プ リキ)は、その英麗な外観、耐食性、加工性、強 装性能、半田性に優れ、容器用鋼板として著しく 優れた適性を有している。而して、その最大の欠 点はSn地金の高騰により、その価格が著しく高い ことにある。そのため、 Sn付着虽の波少による Cost Down が計られているが、その場合、耐食性の 低下が問題である。

就中、溶接缶用素材として低 Sn付滑量、将にSn ノッキ量片面当り 2.5 ダ/ n 未満 (所 間 † 2 5 ブ リキ)の場合、溶接部及び溶接部近傍の溶接時の 熱影響部は、Fe-Sn 系合金層(主として、 FeSn2 層)の発達により、メッキ層表面まで合金層が成 長し、黒灰色にその表面が変色し裕接部外観が劣 化するとともに、この部分は塗装性能(塗料密盤性、塗装後耐食性)も著しく劣る等の問題を生じている。

本発明は、このような問題点を解決し、低Snーメンキ 最で溶接性が優れ、溶接部における欠陥の発生しない、又耐食性の優れた容器用鋼板を提供することを目的とするものであつて鋼板表面にいメッキを施し、次いでSnメッキを行つて直ちにクロメート処理を施すか、或いはSnメッキ後加熱を強性(Melt 処理)を行つてからクロメート処理を施すことによつて目的を違成せんとするものである。

本発明のその二は剱板安面に片面当り 3 0 ~ : 0 0 0 ng/m²の Ni メッキと、 1 0 0 ~ 2 0 0 0 ng/m² の Snメッキを施して、温度 2 4 0 ~ 3 5 0 0、好

選しやすい。

一方、Ni-Sn 合金層(主として、NiSn合金層) は粒状の微糊な結晶でありメッキ層厚さ方向への 成長が少なく平面方向に成長するのでメッキ層要 面迄メッキ層が上記の如く少なくても到達するこ とがなく、器接部に欠陥を生ずることがない。

Niメッキ層の厚さは片面当り30~1000g/㎡の範囲である。30g/㎡未満では、上記の如きピンホール防止効果による耐食性向上効果及びFeSn2合金層の腎接時における成長抑制効果が得られない。1000g/㎡をこえると、その効果が飽和するとともに、価格が高くなるので軽弱的でなるなるので1000g/㎡以下が好きしい。而して、最適範囲は100~500g/㎡である。

Sn メッキ層の厚さは片面当り100~2000m/元の範囲である。100m/元以下では、搭接時に低融点 Sn 金属の効果による広範な容接条件の範囲(加圧力、電流等)における均一な溶接ナケットの形成が阻害される。又、Sn メッキ層自体のピッホールが多くなり、製缶容器内部の腐食環境、

ましくは250~300℃で加熱浴融処理を施して後、Cr換算量で2~20m/moのクロメート被膜 層を形成する溶接容器用鋼板の製造法である。

次に本発明について更に詳細に説明する。

まず鋼板表面に片面当り 30~1000~11、 好ましくは100~500mg/mºのNiメッキを施し、 さらに100~2000g/㎡、好ましくは300~ 1000m/nºのSnメッキが施される。すなわち NI下地処理を施すことによつて、Snメッキ録を減 少しても重ねメツキによる相剰効果によるピンホ ールの生成量が少なくなり耐食性が向上すると共 に、 Ni下地メンキ層の存在により、電気抵抗溶接 における熱影響部(溶接部、溶接即近傍)の Fe-Sn 系合金層(主として FoSn2合金層)の成長を抑 制するため、啓接部において低 Sn付着量の場合に も、前記の如き路接欠陥の発生による外観、性能・ の劣化を生じない。加熱によつて生じる PeSn2 合 金層は従来から知られているように、柱状結晶で ありょッキ層厚さ方向への成長が著しく低 Sn メッ 中量の場合、ノンキ層表面の方向に成長表面層迄

例えば酸素 Free のクエン酸水溶液中での鋼板 成いは Ni に対する Sn 金属の陽極防食効果が著しく 減じられるので好きしくない。 2 0 0 0 m/m を こえると、その効果が飽和するとともに、経済的でなくなり、本発明の Ni メッキ下地処理の意味が なくなる。而して、好ましくは 3 0 0~1 0 0 0 m/m の範囲が好きしい。

Niメッキは通常の Ni メッキ法で行われる。 メッ キ方法、 メッキ条件符 に規定しない。

例えば、

A)ワット浴による Ni メッキー

NiSO4-6H2O 200-3009/L

Nic 2 - 6H2O 20~ 50.7/2

H3BO 2 20~ 409/2

(B) スルファミン酸浴による Ni メッキー スルファミン酸ニッケル 300~4508/A

H₃BO₃ 20~ 409/2

電流密度; 5~3.00.A/dm2

俗温 ;30~70℃

Sn メッキは通常の Sn メッキ法で行われる。特

に条件。方式規定しない。

(例) フエロスタン浴

フェノールスルフォン酸 10~304/0(硫酸化 換算して)

SnSO 4

4.0~808/2

ENSA(添加剤)(USS デュポン製) 5~158/& ハロゲン浴

塩化第一錫

50~1008/B

フツカソーダ

15~ 358/6

水素化硫貨カリウム。

40~ 609/1

塩化ナトリウム

30~ 608/2

ナフトールスルホン酸 1~ 5&/&

電流密度 5~100A/dm²

3 0 ~ 6 0 °C 浴温

水洗後従来と同様の方法のクコメート処理を施 すか或いはフラツクスを盗布後加熱溶融処理 (Melt 処理) 2 4 0 ~ 3 5 0 Cを行なつてからク ロメート処理を行なりことによつて構成される。 メッキ後或いは Melt 処理後の Sn 表面の酸化物 除去と同時にクロメート被膜を形成させ、 Sn酸化

の酸化腹抑制効果が小さく、塗装性能の向上効果 が得られない。20g/㎡をこえると、上記効果 は 良好であるが務接時の均一左ナゲツトの生成を 阻害するので20g/㎡以下であることが必要で あり、好ましくは5~15畇/㎡(クロム換算量) の範囲で施される。

クロメート処理方法として通常のクロメート処 型法でよく、不可避的不純物として含有される 504-2, Ce- 等の不純物を含む、クロム酸、クロム **敵塩(クロム酸アンモン、クロム酸ソーダー、ク** ロム歌カリ etc)、重クロム改塩(重クロム酸アン モン、重クロム酸ソーダー、重クロム酸カリ etc) の水溶液中で浸渍又は陰極電解処理を施す。

例えば、濃度10~1208/1、好きしくは20 ~ 6 0 多/ & の 水密 液 が使 用 され 、 憂 徴 処 理法 で は温度、常温 ~ 7 0 C、好きしくは 3 0 ~ 5 0 C、 処理時間 0.5~5秒、好ましくは 1~3秒間 燈型される。 陰極処理の場合には 5 ~4 0 A/dm²、 好ましくは 7.5~ 2 C A/dm²の電 施密度で上記温 废、 上記時間処理の範囲でクロメート処理が施さ.

物の貯蔵時の成長を抑制し、塗装性能の向上を、 従来のプリキと同様に行なう。 Ni メッキ及び Sn ノッキを施してから加熱容融処理 (Melt 処理)を 施すことにより、Snメッキ層の金属光沢の増加に よる外観向上と Ni-Sn 系合金層の生成による更に 一層の耐食性向上を計る。

加熱器融処理 (Melt 処理) は、Snメッキ 後水洗 して、そのままあるいは水溶液フランクスを益布 して、空気中或いは非酸加性雰囲気(例えば N₂ 雰 目 気) 中 で 2 4 0 ~ 3 5 0 ℃ 、 好 ま し く は 250 C~300CでSn メッキ層が Melt される。

フラックスは、浸漬処理又はスプレイ処理によ り、何名はメツキ浴がフエロスタン浴では、

フェノールスルフォン酸 2~109/0(硫酸に換算して)

SnSOA

2~108/2

を強布して、Moltされる。

而して、本発明の方法において施されるクロメ 一ト被換量は溶接性の点から著しく重要であり、 クロメート被膜量の厚さは Cr 換算量で 2~20mg/nº の範囲で行われる。 2 m/n 未満では、 Snメッキ層

れ、クロメート処理後水洗、乾燥され

					電気抵抗による熔接性		推进	•	培扱熱影響部の	
杖験	Niノツキ条件とNiメツ	Snメッキ条件と Snメツ		クロメート処理条件 とクロメート被膜量	遊性熔接 知 施 囲 名			耐蝕性	塗装性 · 二次密	塗装後 耐酸性
16.	キ層の被膜腫 (片面当り)	キ層の被膜量(片面当り		(片面当り)	範 囲 名	八 観 一			冠性	Mi DRCI
i	(3009/6 NiSO.) (6H ₂ O-359/6 NiCe ₁ .6H ₂ O- 259/6 H,BO,	(60 <i>9/e</i> SnSO, -) 15 <i>9/e</i> フエノール スルホン酸 (硫酸換 算) - 1.0 <i>9/e</i> ENSA	た し	308/6Na ₂ Cr ₂ O ₇ ・ 2H ₂ O浴 4 5℃中で、 試料を陰極とし、5 A/a㎡の電流密度で 電解処理、クロメー	0	6		©	©	©
	浴を用い、電流密度 4 A/d m³で 700 mg/ m³ Ni メッキ	俗を用い、電硫密度 20A/d m² で 100mg/m² の Sn メッキ	. •	ト付着量(クロメー ト中のCrで)10mg/i	٠ -,		<u>.</u>			
2	(309/8 スルファミン酸ニッケル 一308/8 H,BO,/ 俗を用い、電流密度30	759/6 SnC6: - 259/6 NaF - 508/ 6 KHF-459/6 NaC6-29/6ナフト ルールスルホン酸		108/0 CrO。80 C 中に没債処理、 クロメート付着量(2 ロメート中の Crで) 4 mg/m²	7	© .	 ©	. O	•	•
	A/dm ² で500mg/m ² Ni メッキ	浴を用い、電流密度50 A/m²で303mg/㎡ Snメ シキ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			
	1と同一条件で 250 <i>m/</i> ㎡のNiメンキ	1と同一条件で 550 mg/m ² の Sn メッキ	48/8 SnSO ₄ -48/ ピフエノールスルホン酸 (硫酸換算) 水溶液をフラックスとし	浴 6 0 ℃中で試料を 陰極として、電流密	ŧ,	<u>a</u>		⊚	O	Ð
3			小俗板をファックへとして途布し直接通電化より 260℃に急熱直ちに水中へ入れ急冷して光沢付	クロメート付着量(/ ロメート中のCrで)	,	. .	. •			
4	2と同一条件で 100 吻/π [*] のN i メンギ	2と同一条件で 700mg/n³のSnメッキ	. 周波加熱装置を用い 280℃に急速加熱 直 ちに水中へ入れ急冷し	308/6(NH.)。Cr. Qr. 45 で中で12A/dm で 45で中で12A/dmで 理クロメート付着量 (クロメート中のCア	©	•	. ©	©		•
			て光沢付与	12 mg/m²		· ·				
•					•	·			•	
		•			. :		•			
	•		•				•		第1表	Juej
	5 2と同一条件で、 50 mg/m³のNiメン	1と同一条件で 1000 <i>mg/m¹の</i> Snメツ	3 と同一条件で光沢 キ 付与	1 と同一処理	Ø	Ø	0	©	. ©	. 0
-	6 2と同一条件で 250mg/mのNiメツ	2 と同一条件で キ 550mg/m ¹ のSnメツキ	4 と同 <i>一</i> 条作で ト 光沢付与	4と同一処理	0	©	. ©	•	· ©) .
	 1 と同一条件で 500mg/m²のNi メッ 	1 と同一条件で キ 300 mg/mのSnメッ	3 と同一条件で * 光沢付与	3と同一処理	. ©	0	0	Ø) (©	⊙
	Ni メッキカし	1 と同一条件で 150両/π [®] の5nメン	た し ヤ	1 と同一処理	· Δ	×	0	×	· ×	.
•	9	J. と同一条件で 1500 <i>™g/m[®]</i> の Snメッ	3 と同一条件で + 光沢付与	A L	. ©	x	. 0) Δ	. '.0
i	1 と同一条件で 2 5 m/mのNi メッ	1 と同一条件で キ 500町/mのSnメツ	3 と何一条件で キ 光沢付与	3と阿一処理	0	×	. Ö	·, c) ×	<u>Δ</u>
1	11 2と同一条件で 10号/m ² のNiメッキ	2 と同一条件で 30mg/m [®] の Sn メッ:	. な. し *	4と同一処理	×	×	0	· Δ	. ×	. x

〇 ... 比較的良好 (注) 1. の… 著しく良好 × … 著しく劣る △…ヤヤ劣る

- 2. 性能評価法の説明
- (1) 硫酸鋼試験によるピンホールの評価 Cone の H₂SO₄で表面を清浄化後、5 多の CuSO4・5H2O水溶液中に50 Cで1 分間浸槽 後の Cu析出量で評価。
 - . (2) : 溶接性の評価

電極として銅Wire(約15mmø)を移動させた から加圧下で重ね合わせ電気抵抗溶接を行なう方 式(スードロニック・タイプ)の密接法により、 均一なナケット形成及び充分な階接強度が得られ る電流範囲及び加圧力の範囲でその常接性を評価 するとともに、溶接時の熱影響により容接部及び 溶接部近傍の外観変色の度合により溶接部の外観 を評価した。

(3) 強装後の性能評価

エポ中シフエノール系塗料を 4.5 μ 塗装後、 1.5 多 NaCdと 1.5 多クエン酸を含有する空気飽和 水溶液中に96時間長漬後、ゴバン目試験で二次

正 書 (方式)

昭和55年11月十日

特許庁長官

1.事件の表示

昭和55年特許顯第96888号

熔接缶容器用鋼板とその製造法

3. 補正をする者

符許出額人 事件との関係

東京都千代田区大手町2丁目6番3号 住 所

(665) 新日本製鐵株式会社 '名

> 斎 藤 英四郎 代沒者

平 105 電 (503)4877 4.代 理

東京都港区凸新橋1-12-1 第1森ビル8階

弁理士(6496) 吉

昭和55年10月3日 '5. 補正命令の日付

: 昭和55年10月28日 補正命令の発送日

明細書の発明の名称の欄 6. 補正の対象

発明の名称を「榕接缶容器用鋼板とその製 7. 裾正の内容

塗料密治性を評価し、又強装面にスクラッチを入 れて上記浸資後のスクラッチ部の腐食状態で塗装 後耐食性を評価した。

4) 耐食性の性能評価

試料を 6 2 mi の円形に打抜き、 0.5 % Na 2 CO 3 溶液中で試片を陰極とし、 1.5 A の電流を 3 O 秒 間電解洗浄し、水洗、乾燥した後、試片を試験槽 の底に装着し、2.18N-H₂SO₄ 23ml、3 fH₂O₂ 2 ml、 409/LNH SCN 25m を混合し試験槽に入れ、2 時間後3分H2021mを加え攪拌し、ピーカーに移 す。比色計を用い溶液中の唇屑している鉄量を分 析する。(ISV 法)

上記の結果から、明らかなように本発明による 製品(1~7)は、比較材(8~11)に比べて 著しく優れた性能を示す。

代理人

